

TAB 6.3 x 0.8 with Action Pin
Flachstecker 6.3 x 0.8 mit Action Pin

Title

Contents	Page	Inhaltsverzeichnis	Seite
1. SCOPE		1. ANWENDUNGSBEREICH	
1.1 Content		1.1 Inhalt	
1.1 General terms		1.2 Allgemeine Bedingungen	
2. REFERENCED DOCUMENTS		2. ANZUWENDEnde UNTERLAGEN	
2.1 General documents		2.1 Allgemeine Unterlagen	
2.2 Product overview		2.2 Produktübersicht	
2.3 Application		2.3 Verarbeitung	
3. REQUIREMENTS		3. ANFORDERUNGEN	
3.1 Contact description		3.1 Kontaktaufbau	
3.2 Materials		3.2 Werkstoffe	
3.3 Requirements and tests		3.3 Anforderungen und Prüfungen	
3.4 Test process		3.4 Prüfablauf	
3.5 Contact surface PCB hole		3.5 Kontaktoberfläche Leiterplattenbohrung	
4. QUALITY RESTRICTIONS		4. QUALITÄTSSICHERUNGSMASSN.	
4.1 Quality check		4.1 Qualitätsprüfungen	
4.2 Requalification tests		4.2 Requalifikationsprüfungen	
4.3 Certification		4.3 Abnahme	
4.4 Inspection and conformity		4.4 Prüfung und Konformität	

Es gilt die Produkt-Spezifikation 108-18707 „Flachstecker 4.8 x 0.8 mit Action Pin“ mit den folgenden Einschränkungen bzw. Ergänzungen.

1. SCOPE
1.1 Content

1. Anwendungsbereich
1.1 Inhalt

Die vorliegende Spezifikation beschreibt den Aufbau, die Eigenschaften, Ausführungsarten, Tests und Qualitätsanforderungen des ACTION PIN's. Der Einpressbereich des ACTION PIN's ist für eine metallisierte Bohrung in der Leiterplatte mit einem Nenndurchmesser von 1.6 mm und einer Leiterplattendicke von 1.6 mm konzipiert. Für den Aufsteckbereich des ACTION PIN's ist ein Buchsenkontakt (z.B. SPT oder MCP 6.3) für Flachstecker mit 6.3 x 0.8 mm Pfosten zu verwenden.

2.3 Application

2.3 Verarbeitung

Siehe Verarbeitungs-Spezifikation Nr. 114-18789

3.1 Contact description

3.1 Kontaktaufbau

Aufsteckbereich: Der Aufsteckbereich ist als Kontaktstift mit dem Querschnitt 6.3 x 0.8 mm ausgebildet. Er weist zur Steckkraftminimierung eine geometrisch definierte Stiftpitze auf. Als Gegenstück dient ein Buchsenkontakt (z.B. SPT oder MCP 6.3) für den Flachstecker mit 6.3 x 0.8 mm Pfosten. Aufsteckbereich und Gegenstück müssen eine identische Oberflächenbeschichtung im Kontaktbereich aufweisen.

3.3 Requirements and tests

3.3 Anforderungen und Prüfungen

Mechanische Prüfungen		
Haltekräfte der ACTION PIN Zone in der Leiterplatte im Neuzustand	≥120 N (Kontaktoberfläche Sn) (Leiterplattenloch Sn)	Nach DIN EN 60352-5 Stand 07/2004, Pkt. 5.2.2.3, Prüfgeschwindigkeit: 10 mm/min
Haltekräfte der ACTION PIN Zone in der Leiterplatte nach Umweltsimulation	≥120 N (Kontaktoberfläche Sn) (Leiterplattenloch Sn)	Nach DIN EN 60352-5 Stand 07/2004, Pkt. 5.2.2.3, Prüfgeschwindigkeit: 10 mm/min
Einpresskräfte	180 N – 600 N (Kontaktoberfläche Sn) (Leiterplattenloch Sn)	Nach DIN EN 60352-5 Stand 07/2004, Pkt. 5.2.2.2, Prüfgeschwindigkeit: 25 mm/min

3.1 Contact surface of PCB hole

3.5 Kontaktoberfläche Leiterplattenbohrung

Die galvanische Verzinnung im Bereich von 0,8 – 1,2 µm ist auf Basis der bestandenen Umweltsimulation nach PG19 (AK-Prüfrichtlinie für Kfz Steckverbinder 04/96) zulässig. Dies gilt nur in Verbindung mit dem Ausschluss der Austauschbarkeit im Reparaturfall wie generell in EN 60352-5 vorgesehen. Diese Abweichung erfolgt aufgrund der prozesstechnisch geringer aufbauenden Zinnschicht gegenüber der bisher vorgesehenen HAL-Verzinnung.